



平成 30 年 7 月 25 日

各 位

会 社 名 三光合成株式会社  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 田 健 宗  
(コード： 7 8 8 8、 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 芹 川 明  
(TEL. 0 7 6 3 - 5 2 - 7 1 0 5)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 30 年 7 月 17 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 公募による新株発行（一般募集）

(1) 発 行 価 格	1 株につき	468 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		1, 735, 905, 600 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	446.04 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		1, 654, 451, 568 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	827, 225, 784 円
	増加する資本準備金の額	827, 225, 784 円
(6) 申 込 期 間	平成 30 年 7 月 26 日(木)～平成 30 年 7 月 27 日(金)	
(7) 払 込 期 日	平成 30 年 8 月 7 日(火)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

#### 2. 双葉電子工業株式会社を割当先とする第三者割当による新株発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	468 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		343, 746, 000 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	171, 873, 000 円
	増加する資本準備金の額	171, 873, 000 円
(4) 申 込 期 間	平成 30 年 7 月 26 日(木)～平成 30 年 7 月 27 日(金)	
(5) 払 込 期 日	平成 30 年 8 月 7 日(火)	

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		556,300 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	468 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		260,348,400 円
(4) 申 込 期 間	平成 30 年 7 月 26 日(木)～平成 30 年 7 月 27 日(金)	
(5) 受 渡 期 日	平成 30 年 8 月 8 日(水)	

4. 野村証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	446.04 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	248,132,052 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	(上限) 124,066,026 円 (上限) 124,066,026 円
(4) 申込期間（申込期日）	平成 30 年 8 月 23 日(木)	
(5) 払 込 期 日	平成 30 年 8 月 24 日(金)	

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 30 年 7 月 25 日(水)	488 円
(2) ディスカウント率		4.10%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 30 年 7 月 28 日(土)から平成 30 年 8 月 17 日(金)まで

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,227,329,620 円については、平成 31 年 8 月末までに 1,000,000,000 円を当社九州工場の建設資金等に、平成 31 年 9 月末までに 820,000,000 円を当社連結子会社である SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD. への投融資資金に、407,329,620 円を平成 31 年 5 月末までに当社の借入金の返済にそれぞれ充当する予定であります。

なお、SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD. は、当社からの投融資資金を平成 31 年 9 月末までに新工場の建設資金等に充当する予定であります。

また、返済予定の借入金は、九州工場の建設用地取得資金並びに、投融資を通じて、SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD. の設備資金及び工場建設資金、当社連結子会社である SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA, INC. の工場拡張資金及び新設した東莞三樺塑膠有限公司の会社設立資金等にそれぞれ充当しております。

詳細については、平成 30 年 7 月 17 日に公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。